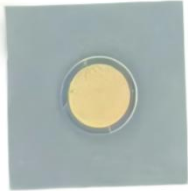


NX4P504-132型
PIN芯片

产品特点:

- ☑ 采用玻璃钝化工艺，耐高压
- ☑ 高隔离，高耐受功率
- ☑ 低串联电阻，插损低
- ☑ 可承受高连续波射频功率
- ☑ 符合RoHS标准



产品描述:

NX4P504-132型PIN芯片结构为台面结构，其I层厚度为50微米。当外加正向偏置时，由于载流子注入导致 I 层呈现低阻导通状态，实现对微波功率的传输，当外加反向偏置时，I 层呈现高阻截止状态，实现对微波功率的反射。

广泛应用于射频开关、移相、衰减电路等等微波控制电路中，特别适合大功率的串联或分流装置使用，包含HF到UHF频段的大功率射频开关电路，电台通信等。

性能参数:

参数	测试条件	单位	最小值	典型值	最大值
反向漏电流	-500V	uA	—	—	1
结电容	-100V @ 1MHz	pF	—	0.15	0.20
串联电阻	+100mA, 100MHz	Ω	—	0.55	0.60
热阻	I _F = 500mA, t _w = 10mS	℃/W	—	12	15
少数载流子寿命	I _F = +10mA, I _R = -6mA	μs	—	1.0	—
I区宽度	—	um	—	50	—

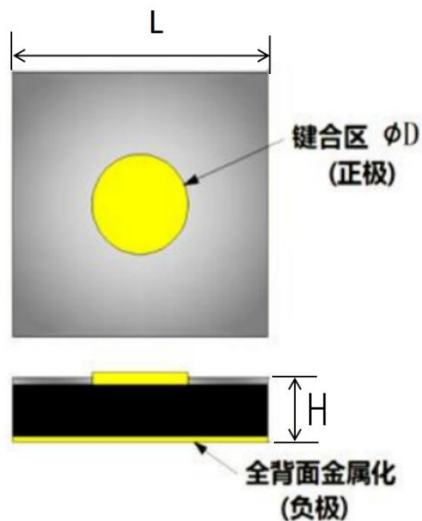
注：1. 不建议在极限条件下持续工作

绝对最大额定参数:

参数	绝对最大值
最大反向电压	500V
热阻最大值	15℃/W
最大结温	+175℃
工作温度	-65℃ to +175℃
储存温度	-65℃ to +200℃

- 注: 1. 超过这些限制中的任何一个或组合都可能对这个装置造成永久性损坏
2. 不建议在这些区域附近进行持续性操作。

外观尺寸:



规格	尺寸 (um)	
	最小值	最大值
边长L	480	500
电极ΦD	165	180
高度H	240	260

清洁与存储:

本产品应在清洁的环境中操作和储存。芯片电极为厚金材料, 键合可靠性高, 但不宜长期暴露在高湿度(>80%)的环境下, 长时间不用时, 宜存储在氮气柜或干燥柜内。

焊接建议:

本产品耐高温, 工艺操作窗口大, 可采用导电胶、软钎焊料等方式进行焊接, 采用金线、银线等进行键合, 工艺操作过程中应遵循ESD控制技术, 欲了解更多技术信息, 请联系15358194655。